

拒絶理由通知書

10/16

特許出願の番号	特願2000-180087
起案日	平成16年 7月23日
特許庁審査官	藤田 裕子 9709 2P00
特許出願人代理人	西澤 均 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

[理由1]

- ・請求項1
- ・引用文献1, 2, 3, 4, 5, 6
- ・請求項2
- ・引用文献1, 2
- ・請求項3～4
- ・引用文献1, 3, 4
- ・備考

引用文献1：スクリーンメッシュのオープニングMつまり開口率を、スクリーン中心部分で最も小さく、四隅部分で最も広くなるようにしている。これは、本願請求項1の印刷図形の配設された領域によって2つ以上に異ならせたこと、本願

請求項2の版枠の外周付近の印刷図形のものよりも内側（中央部）に配設された印刷図形のメッシュ孔による開口率のほうが大きいことに相当する。引用文献1には積層セラミックコンデンサ用途であることは記載されており、これは本願請求項3, 4の積層セラミック電子部品に相当し、引用文献1にはその詳細な構造や製造方法について明記はないが本願請求項3, 4の詳細な構造や製造方法は積層セラミックコンデンサであれば通常有する構造及び製造方法である。

引用文献2：版枠内中央部から周辺部に向けてスクリーンメッシュ素線の横断面形状の面積が減少されており、かつ図面を参照すれば当該メッシュは均等間隔で張設されているので、スクリーンメッシュの開孔率は版枠の外周部分が版枠の中央付近よりも大となっている。してみると、引用文献2第5図のごとく複数の印刷図形によってメッシュ孔が形成された場合、その開孔率は本願請求項1のように印刷図形の配設された領域によって2つ以上に異ならせたものであり、また、本願請求項2のように周辺部に配設された印刷図形の開孔率は中央部の開孔率よりも大きいものとされている。

引用文献3：図1（a）（b）によると、複数配設された印刷図形の領域によって、開孔を横切るブリッジを有するものと、ブリッジを有しないものが存在し、両者の開孔率は異なっている。印刷配線基板用であることも記載されており、請求項3, 4のような積層電子部品に広く適用されているものである。

引用文献4：第2図にあるように、スクリーンの一部において網のメッシュ数を他の部分よりも減少させることにより網の開孔率が高い領域（と低い領域）を設けることが記載されている。セラミック基板に対して印刷を行いチップとすることも記載されており、請求項3, 4のような詳細な構造や製造方法について明記はないがこれは通常有する構造及び製造方法である。

引用文献5：第4図にあるように、印刷板上に複数設けた印刷部分に対してスクリーンメッシュ数を相違するものとしたことが記載されている。メッシュ数の多いものが開孔率が小さく、メッシュ数の少ないものは開孔率が高いものに相当する。電子工業等に応用可能であることも記載されている。

引用文献6：図1にあるように、スクリーン紗の領域に応じて縦糸・緯糸の太さや織り密度等の組み合わせをかえたスクリーン紗が記載されている。各領域によって、メッシュ孔による開孔率は2つ以上に異ならせられている。

[理由2]

- ・請求項1～4
- ・引用文献1～6

· 備考

引用文献 1 ～ 6 には上記理由 1 に記載したとおりのスクリーン印刷版、積層セラミック電子部品の製造方法及び積層セラミック電子部品に関する記載がなされている。それぞれ参照し、もって本願の請求項 1 ～ 4 に係る発明とすることは、当業者であれば容易になしえたものである。

また、塗膜厚みの均質化という本願の効果も、すでに引用文献 1～3 に記載されているものであり、本願が格別の効果を奏するものであるともいえない。

## 引用文献等一覽

1. 特開平04-259556号公報
2. 特開昭63-116893号公報
3. 実願平04-063805号（実開平06-027166号）のCDROM
4. 特開平03-281391号公報
5. 特開昭60-263156号公報
6. 特開平10-202824号公報

この拒絶理由通知書中で指摘した以外には、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせがございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第一部事務機器 藤田 裕子  
TEL.03(3581)1101 ext.3221 FAX.03(3580)6902  
(FAXご送付前には上記TELにご連絡下さい)

## 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野      I P C第7版    B 4 1 F     1 5 / 3 4  
  B 4 1 N        1 / 2 4
- ・先行技術文献
- (大きな開口部は、はんだ量均等塗布のために分割等を行う)
- 実開平07-012237号公報
- 特開平06-000938号公報
- 実開平04-063241号公報
- (印刷パターンにあわせてメッシュ開口形状選択)

整理番号 00557MR

発送番号 272843 4/E

発送日 平成16年 8月17日

特開平05-085077号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

-----

なお、この拒絶理由通知に応答して手続補正を行う際には、同時に意見書等においてその補正の根拠（明細書等における記載箇所等）を明示されることが望ましい。